杭州格林达电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 董事长：蒋慧儿  总经理：方伟华  财务总监：何婷茹  董事会秘书：章琪  独立董事： 吴晖 |
| 时间 | 2025.9.5 下午 14:00-15:00 |
| 地点 | 上证路演中心 |
| 交流内容及具体问答  记录 | 1、公司在2025年半年报中提到“通过该项目的验收及带动的技术提升，公司与集成电路龙头企业进行品质对标，完成客户端供应商资格审查导入”，请公司是否已取得集成电路龙头企业的供应商资格，是否已开始供货？如有是小批量还是大批量？  A：尊敬的投资者你好，公司正稳步推进项目验收收尾工作，进展顺利。公司目前与相关集成电路龙头企业进行品质对标， 处于供应商资格审查导入阶段，公司持续推进相关验证和导入工作，具体业务进展请以公司后续公告为准。谢谢！  2、公司承接到工信部联合攻关项目现在什么进展了？半年报说在收尾阶段，具体到哪个阶段了，是否顺利？预计三季度能完成验证吗？  A：尊敬的投资者你好，公司承接的工信部联合攻关项目处于整体验收阶段，公司正稳步推进项目验收收尾工作，进展顺利，最新信息请关注公司定期报告和临时公告的相关内容。谢谢。  3、公司耗时数年时间终于投产的四川项目，该项目目前情况怎么样？有没有放量？运营情况有没有改善  A：尊敬的投资者你好，公司核心产品已在体系客户LCD 和OLED 的多条重要产线测试成功，由格林达四川工厂导入并实现量供，四川格林达2025年上半年实现营收3,309.84万元，产能逐步释放。谢谢。  4、公司目前在半导体芯片方面，和哪些行业企业有合作？  A：尊敬的投资者你好，公司在半导体材料方面和海内外多家半导体企业,包括国内集成电路龙头企业展开合作。具体信息披露请以公司相关公告为准。 谢谢！  5、从公司半年报内容来看，公司目前各个新产能新项目投产后，在手已经没有什么新项目了，那么公司未来的增长路径是怎么规划的？后续会不会考虑外延式的并购重组方向？  A：尊敬的投资者你好，公司将继续稳固核心产品显影液的市场领先地位，加速推进西南区域项目投产见效，并推进其他重要产线的转产测试进程，同时挖掘新客户需求，强化定制化配套服务能力以增强客户粘性。其次，公司通过创新驱动发展，紧密围绕国家对集成电路、新型显示、高端新材料等战略性新兴产业的发展规划，持续开展以市场需求为导向的技术突破与创新工作。此外，公司正扩大剥离液等新产品在多体系客户中的导入及销售份额。如有涉及并购重组等重大事项的，将严格按照信息披露规则及时公告。谢谢。  6、公司在半导体业务这块，目前占营收多少比例？  A: 尊敬的投资者你好，分行业数据将在公司年度报告相关板块中披露。谢谢。  7、请问宁波聚合公司的减持结束了没有？为什么还结束？还有多少未减持股数？  A：尊敬的投资者你好，宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）的减持计划仍在实施期间内（2025年6月27日～2025年9月26日），谢谢。  8、如公司承接的工信部联合攻关项目完成验收，公司是否即取得相关集成电路龙头企业的供应商资格，启动供货？  A：尊敬的投资者你好，公司承接的工信部项目，目前正与国内芯片龙头企业进行联合体协同开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，公司正稳步推进项目验收收尾工作，进展顺利。通过该项目的验收及带动的技术提升，公司与集成电路龙头企业进行品质对标，完成客户端供应商资格审查导入，推动后续在半导体集成电路企业及半导体其他领域的产线验证和量供导入。谢谢！  9、据京东方投资者信息披露，成都京东方oled 8.6代线已完成工艺设备搬入，预计2026年量产。请问公司是否为该产线的供应商？  A：尊敬的投资者你好，在西南地区，公司核心产品已通过多家体系客户的产线测试和导入，取得了显著进展：核心产品已在体系客户LCD和OLED的多条重要产线测试成功，由格林达四川工厂导入并实现量供。谢谢！  10、公司在半导体板块，目前有什么布局？有什么样的规划？  A：尊敬的投资者你好，公司在半导体板块的布局和规划主要体现在以下几个方面：1、技术研发与产业化突破：公司承接了工信部项目，正与国内芯片龙头企业协同开展大规模集成电路用图形化显影液产品的研发及产业化应用验证，目前处于整体验收阶段。通过该项目的验收和带动的技术提升，公司与集成电路龙头企业进行品质对标，完成客户端供应商资格审查导入，推动后续在半导体集成电路企业及半导体其他领域的产线验证和量供导入。2、产品应用拓展：半导体用显影液和稀释液已在半导体功率器件头部企业形成稳定量供，并持续在国内外下游半导体客户端开拓市场。同时，公司通过省级项目“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”，完成技术开发验证和产业化应用测试，进一步拓宽在半导体领域的应用范围。3、产学研合作与技术创新：公司聚焦湿电子材料领域的“卡脖子”技术和本土化替代，加强电解纯化工艺、杂质控制等关键技术攻关，建立完善的产品评估、品质管控体系，致力于实现中高端集成电路产线的产业化规模应用，增强产业链自主可控性。谢谢。  11、为什么今年半年报，净利润下滑的比营收下滑多，是什么原因？请公司解答一下。公司对行业下半年有什么判断？  A：尊敬的投资者你好，受产品单价波动、原料成本波动、新厂投用等多因素影响，营收及利润均有不同程度的下滑。整体来看，2025 年全球新型显示产业在复杂环境中持续调整。供应链成本上涨推升终端产品成本增加，进一步压制需求。全球消费电子供应链格局正在动态调整，直至形成新的平衡。 与此同时，技术创新仍是行业发展的重要推动力。AI 算力的提升正循序渐进地影响需求增长和技术变革。显示技术的发展也为市场带来新机遇。谢谢！  12、公司半年报提到的工信部项目和芯片龙企业，是哪家芯片龙头企业？是哪方面的芯片项目？  A：尊敬的投资者你好，项目相关信息以公司公告内容为准，谢谢。  13、公司现在是否具备向中芯国际等公司供货的能力？  A：尊敬的投资者你好，目前公司核心产品相关技术指标已达到SEMI G5标准要求，公司在半导体材料方面和海内外多家半导体企业,包括国内集成电路企业展开合作。具体信息披露请以公司相关公告为准。 谢谢！  14、公司有产品导入中芯国际实现供货吗？  A：尊敬的投资者你好，目前公司核心产品相关技术指标已达到SEMI G5标准要求，公司在半导体材料方面和海内外多家半导体企业,包括国内集成电路企业展开合作。具体信息披露请以公司相关公告为准。 谢谢！ |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可  作为附件） | 无 |
| 日期 | 2025年9月5日 |